

更なる発展へ！次世代市場を徹底分析！

5G・基地局・スマートフォン用プリント配線板技術の解析

2019年度版 プリント配線板技術ロードマップに関するセミナーをロードマップ委員会より11月21日(木)に回路会館(西荻窪)で開催します。

2019年度版 プリント配線板技術ロードマップのトピックス紹介に加え、2021年度版 プリント配線板技術ロードマップに記載予定の内容も含めて紹介します。

ぜひご参加くださいますようお願いしております。



募集要項

開催日時：2019年11月21日(木) 13:00~17:00

(受付開始 12:30~)

会場：回路会館地下1階会議室

東京都渋谷区西荻北3-12-2/一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

地図：http://jpca.jp/jpca_about/access/

主催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

●プログラム (時間は質疑時間5分を含みます。内容については予定であり変更する場合があります。)

13:00-14:00	5Gの関連技術(モバイル電子機器、オートモーティブエレクトロニクス、ハイパフォーマンスコンピューティングの技術及び市場動向) 宇都宮 久修 (WG5 主査)
14:00-14:30	アンテナインパッケージの動向 宇都宮 久修 (WG5 主査)
14:30-14:50	休憩
14:50-15:30	400Gbps イーサネット基板の動向 飯長 裕 (沖プリントテッドサーキット株)
15:30-16:00	高周波用 FPC (フレキシブルプリント配線板) 吉沢 浩一郎 (日本メクトロン株)
16:00-17:00	5G スマホの市場性 中根 康夫 (みずほ証券株)

※10月28日(月)プログラムを更新しました

●参加要項

定員：先着100名

参加費：20,000円(税込) JPCA/JEITA 会員様

50,000円(税込) 非会員様

※既に本書をご購入頂いた方でセミナーのみご参加をご希望される場合は、上記価格の半額となります。

※懇親会にご出席希望(オプション)の場合は、5,000円を頂戴いたします。

※上記費用には、聴講料、2019年度版プリント配線板技術ロードマップ(ダウンロード版)代金が含まれます。

※お申込み後の、お客様都合によるキャンセルは、本書のダウンロードアドレス発行後はお受け致しかねます。

※ご受講予定者と別の方が受講される場合には、事前にメール等でご連絡を頂くか、セミナー当日に受付にてお申し出ください。

※講師の意向により投影資料の配布は致しかねます。

※懇親会のキャンセルは、11月18日(月)までにお申し出ください。それ以降の場合は、ご返金できませんのでご注意ください。

●お問い合わせ

一般社団法人日本電子回路工業会 ロードマップセミナー係

事業部 青木 (std2@jpca.org) TEL:03-5310-2020 FAX:03-5310-2021

●申込方法

別紙申込書に必要事項をご入力の上、メールまたはFAXで11月18日(月)迄にお申し込み下さい。

工業会からご担当者様宛にご請求書をお送りさせていただきます。

